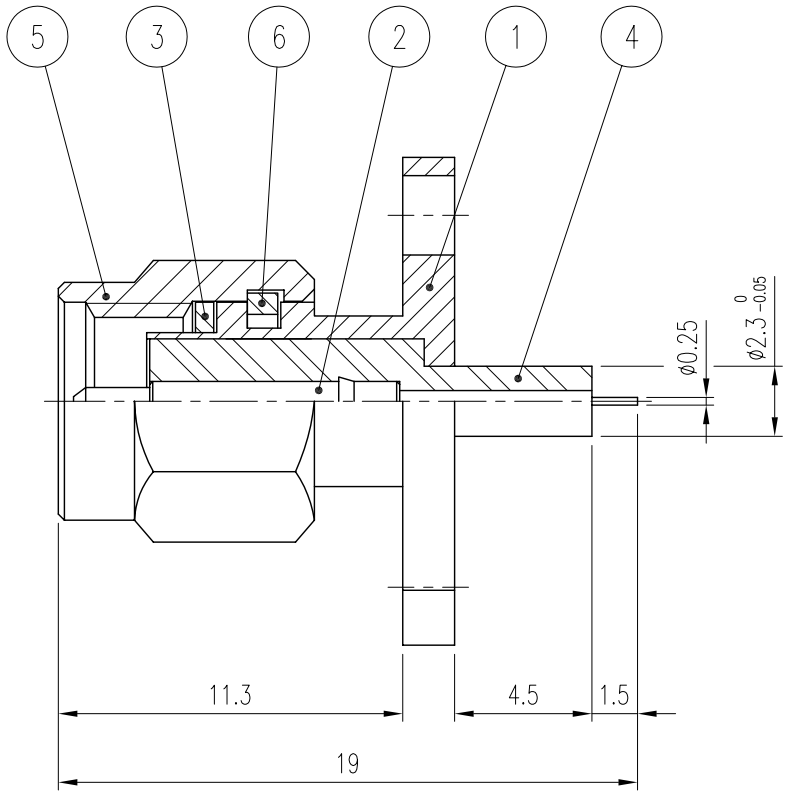
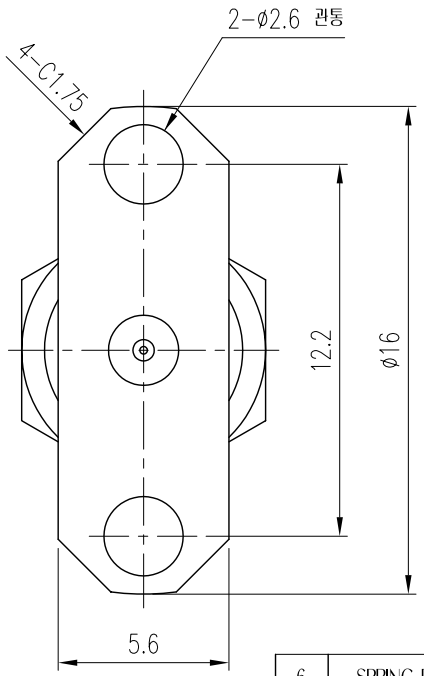
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	SPRING RING	1	SUS	부동태처리	DSR00002-5/1 (R2001)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-5/1 (K2001)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01509-N/1 (H2139)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00004-N/1 (G2001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01906-5/1 (E2182)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01587-5/1 (D2164)

대체가능재질

공통공차

.* ±0.1

.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 1999. 8. 13.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 7/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-P-H2-R VER.0

A4

도번 CN01376-7/1

K314-488-001